

# DISCRETE

Tr  
Di  
SAW

All lineup of our products, The world knows that.



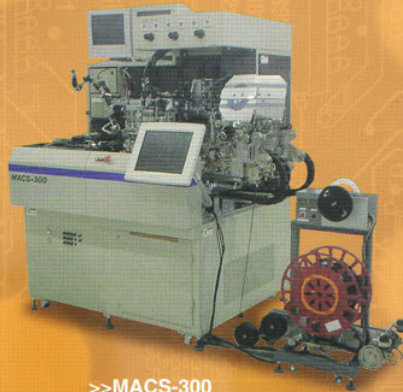
>>BESTEM-D03



>>CPS-4000L

## Front End ▶▶▶

|           |          | ダイボンディング・他<br>Die Bonding etc.                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MINI MOLD | FORMING  | <b>BESTEM-D03</b> マルチパーパスダイボンダー<br>Multi-Purpose Die Bonder<br>・半田を基本に金共晶、エポキシ接合にも対応<br>・Gold eutectic and epoxy bonding are applicable on the basis of solder bonding<br>ダイボンダー<br>Die Bonder |
|           | FLATLEAD | <b>BESTEM-D01/R</b> フレキシブルエポキシダイボンダー<br>Flexible Epoxy Die Bonder<br>・実装スピード 0.18秒<br>・Mounting Speed 0.18 sec<br>ダイボンダー<br>Die Bonder                                                         |
| POWER     | LEADLESS | <b>CPS-4000L</b> 高速ソフトソルダーダイボンダー<br>High-Speed Soft Solder Die Bonder<br>・半田接合で、実装スピード0.55秒<br>・Mounting speed of 0.55 sec through solder joint<br>ダイボンダー<br>Die Bonder                        |
|           |          | <b>CLIP BONDER</b> クリップボンダー<br>Clip Bonder<br>・世界初クリップ搭載マシン<br>・The world first clip bonder<br>クリップボンダー<br>Clip Bonder                                                                         |
| FC        |          | <b>CPM-7000Series</b> フリップチップダイボンダー<br>Flip Chip Die Bonder<br>・超音波接合・熱圧着 選択可<br>・For ultrasonic bonding or thermo compression bonding<br>ダイボンダー<br>Die Bonder                                 |



>>MACS-300



>>CAP-500

## Back End ▶▶▶

切断  
Cutting

成形  
Forming

測定  
Testing

捺印  
Marking

検査  
Inspecting

テーピング  
Taping

### MACS-II マルチバックエンドシステム Multi Back-End System

・0.28秒/個の高速処理 ・High-speed process 0.28 sec/work

切断  
Cutting

成形  
Forming

測定  
Testing

捺印  
Marking

検査  
Inspecting

テーピング  
Taping

### MACS-300Series リードレスマルチバックエンドシステム Leadless Multi Back-End System

・ダイシングテープよりピックアップ 0.3秒/個の高速処理 ・High-speed pick up process 0.3 sec/work through dicing

測定  
Testing

捺印  
Marking

検査  
Inspecting

テーピング  
Taping

**Test  
Mapping**

### CAP-500 ダイスピッカー Die Sorter

・φ8インチウエハー、テープ収納  
・For φ8 inch wafer and taping

テーピング  
Taping

ニードルレスピックアップ技術  
Needleless pick up technology